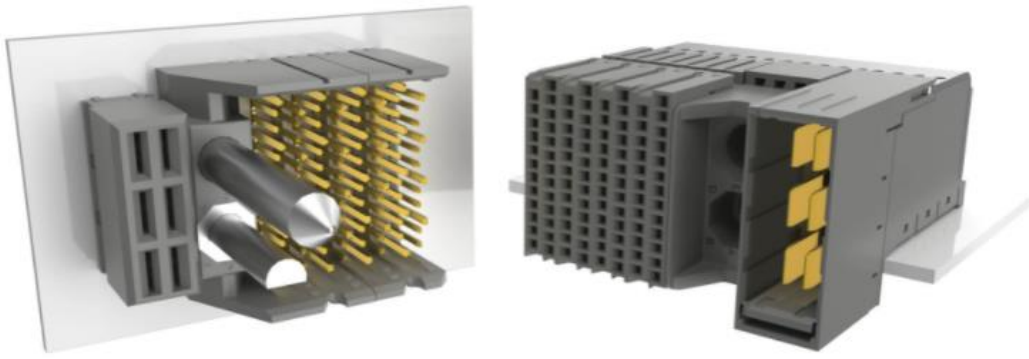




SAMTEC 新製品リリース情報

製品名	XCede® HD 高密度バックプレーンシステム		
概要	16 Gbps の伝送を実現する高密度高速バックプレーンコネクタシステム。電源やガイドなどバックプレーンシステムとして必要とされる様々なオプションを用意、秀でた組み合わせにて柔軟性と拡張性を提供します。従来のバックプレーンと比較した際、高密度にて基板の省スペースに貢献します。		
特長	<ul style="list-style-type: none">● 3-、4- そして6ペアの基本構成（高さ方向）● 4、6、そして8列を準備（横方向）● 1インチ内にて84ペアの差動信号を構成可能● 1.8mmピッチ（列（横）方向にて）● 12から48差動ペア（1モジュールとして）● 3.00mmの有効箆合長● 任意のシグナル/グランドアサインがオプションで可能● 更なるオプションとして電源、ガイドポスト、方向キーやサイドウォールを準備● 85Ωと100Ωを選択可● 活線挿抜（シーケンス）用のコンタクト長さとして3段階が可能● コストに貢献した設計、高速信号以外でも使用可能		
仕様	<ul style="list-style-type: none">● コンタクト材質：リン青銅（オス側）、銅合金（メス側）● 定格電流：1.5mA● 定格電圧：48VAC● 挿抜耐久性：最大250回		
用途	<ul style="list-style-type: none">● 通信、ネットワーク機器● HPC● データ記憶装置● CT/MRI		
発売日	2022年2月	価格	弊社代理店より回答
製造発売元	会社名：サムテック ジャパン エルエルシー 所在地：横浜市港北区新横浜3-8-8 日総第16ビル2F TEL：045-475-1385 FAX：045-475-1340 代表者名：林 律雄		
製品に関するお問い合わせ先	（部署名／担当者氏名／連絡先） E-mail アドレス：japan@samtec.com		



HIGH-DENSITY, SMALL FORM FACTOR



Xcede® HD

Up to 84 pairs
per linear inch



Traditional Backplane

Up to 76 pairs
per linear inch

(Both shown with six 4-pair, 8 column receptacles)